

# Yellow Green Chip--ORT007YGL

## 1. Scope (范围) :

- This specification applies to Gap yellow-green LED chips.
- 本技术条件适用于 Gap 黄绿色发光二极管芯片。

## 2. Structure (结构) :

- Mesa Type: rough surface. 台面型: 粗糙表面
- Electrodes (电极) :  
P (Anode) Side: aluminium alloy. P 面 (阳极) : 铝合金  
N (Cathode) Side: gold alloy. N 面 (阴极) : 金合金

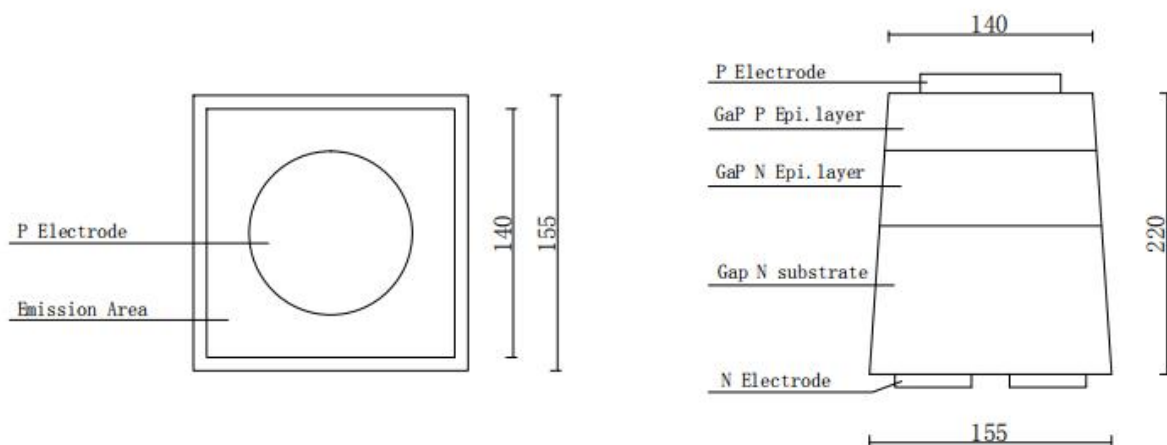
## 3. Size (尺寸) :

- Top Size:  $140\mu\text{m} \times 140\mu\text{m} \pm 20\mu\text{m}$ ; Bottom Size:  $155\mu\text{m} \times 155\mu\text{m} \pm 20\mu\text{m}$
- Chip Height (芯片厚度) :  $220\mu\text{m} \pm 20\mu\text{m}$
- Pad Size (电极尺寸) :  $92\mu\text{m} \pm 10\mu\text{m}$
- Pattern Drawing: fig.1. 模型图: 附图 1

## 4. Electro-Optical Characteristics (光电性能) :

( $T_a = +25^\circ\text{C}$ )

Parameter 参数名称	Symbol 符号	Unit 单位	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Test Condition 测试条件
Forward voltage 正向电压	$V_F$	V		2.35	2.5	$I_F = 20\text{mA}$
Reverse current 反向电流	$I_R$	$\mu\text{A}$			10	$V_R = 5\text{V}$
Peak wavelength 峰值波长	$W_{lp}$	nm	568	572	575	$I_F = 20\text{mA}$
Luminous Intensity 发光强度	$I_v$	mcd	5.5	7		$I_F = 20\text{mA}$



unit:  $\mu\text{m}$

fig.1



## 5. Packing and Labeling (包装及标签) :

- Packing (包装) : Sheet Type 蓝膜
- Each pellet is mounted on an adhesive sheet with wire-bonded electrode side up.  
每粒晶片键合电极面朝上装在粘性膜上
- Labeling (标签) : Each lot has a label sheet、writing Type、Lot No、Pcs、Avg  $P_o$ 、 $V_F$ 、 $Wlp$  and quantity of good chips.  
每张芯片都附有一张注明型号、批号、张数、 $P_o$ 、 $V_F$ 、 $Wlp$  平均值以及合格芯片数量的标签

## 6. Application Notes (使用说明) :

- All data are measured by Orient' s tester on bare chips within 98% of the nominal value.  
所有参数均系使用奥伦德测试仪器在晶片条件下测试, 98%符合标称值范围
- Measurement error for dominant wavelength and peak wavelength is  $\pm 5nm$   
主波长和峰值波长测量误差 $\pm 5nm$